(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1984 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994

(43) 国際公開日 2005 年9 月22 日 (22.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/089036 A1

(51) 国際特許分類7:

H05K 13/08

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/003969

(22) 国際出願日:

2005年3月8日(08.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

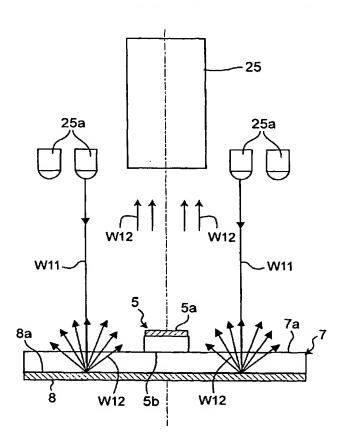
特願2004-072174 2004年3月15日(15.03.2004) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 酒井 一信 (SAKAI, Kazunobu).

- (74) 代理人: 河宮治、外(KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号IMPビル青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

/続葉有1

- (54) Title: METHOD AND EQUIPMENT FOR INSPECTING MOUNTING ACCURACY OF COMPONENT
- (54) 発明の名称: 部品装着精度の検査方法及び検査装置



- (57) Abstract: A component is mounted at a component mounting position on the component mounting side surface of an inspection substrate formed of a light transmitting material and having a reflective surface arranged on the surface facing the component mounting side surface while directed toward the component mounting side surface. The component mounting side surface of the inspection substrate is irradiated with light, and the light is allowed to pass through the component mounting side surface to be reflected off the reflective surface. Outline of the component formed by the reflection light emitted from the periphery of the component through the component mounting side surface is then imaged and the mounting accuracy of the component is calculated based on that image.



IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

-- 国際調査報告書